親愛的產業先進：您好

感謝 貴公司長久以來對VLSI-TSA and VLSI-DAT研討會的支持，讓本會議得以針對半導體產業之技術發展重點，規劃符合國際脈動的豐富議程。同時，因應COVID-19防疫措施，採以現場會議搭配視訊方式舉行，更臻嘉惠國內外產學業界及莘莘學子們的互動學習機會。

2021 VLSI-TSA and VLSI-DAT將於4月19日至22日假新竹國賓飯店舉辦，大會已確認邀請到Stanford University的Prof. Evan Reed，將以【Material Science using AI】為題；Hitachi 的Dr. Masanao Yamaoka與台積電Dr. Lipen Yuan分別以【Domain-specific In-memory Computing Architecture: CMOS Annealing Machine to Solve Combinatorial Optimization Problems】及【Logic Technology Scaling: Present and Future】為題給予精闢的演講；此外，Olin College of Engineering的Prof. Richard K. Miller和Prof. Takao Somey of The University of Tokyo分別以【Thoughts on the Future of Higher Education: Lessons from 20 Years of Experimentation at Olin College】與【Electronic Skins for Robotics and Wearables】為題；Massachusetts Institute of Technology的Prof. Song Han 就【Putting AI on Diet: TinyML and Efficient Deep Learning】為題，共同為大會帶來精采可期的演講。

 同時，亦安排兩場聯合議程 (Joint Special Session) 分別就【In-Memory Computing】與【Design-Technology Co-Optimization and Advanced Packaging】邀請國際聞名專家學者共同探究相關技術的發展現況、應用及挑戰。大會另精心規劃深度短期課程探討Advanced Processing for Future Nodes、AI Devices to Systems、Compiler for Domain-Specific AI Accelerators，以及總計逾百場專題演講與優質論文發表專題演講，內容涵蓋Circuits and Sensors for Advanced Bio-medical Applications、Machine Learning Applications on EDA、CMOS LiDAR for Autonomous Driving、Area of AI Accelerators, Design Methodology and Hardware Software Co-design等備受矚目的新題材，全部課程開放所有與會人士選擇，提供半導體製程及設計相關之研究人員領先技術的交流平台，促使我國半導體技術更臻精進。

VLSI研討會為國際間超大型積體電路設計及製造領域重要技術研討會之一。本會議辦理經費除工業技術研究院支持外，仍需業界慨允贊助。祈請　貴公司支持，共襄盛舉，特函懇請贊助，俾促成研討會順利成功，無任感荷！

 耑此， 順頌 時祺

|  |
| --- |
| **2021 VLSI-TSA 及 VLSI-DAT 大會敬謝** |
|  | **VLSI-TSA** |  **VLSI-DAT** |
| 大會主席 | 莊紹勳 交通大學 |  Hidetoshi Onodera 日本京都大學 |
|  | 吳志毅 工業技術研究院 |  林宗賢 台灣大學 |
|  |  |  |
| 大會議程主席 | Toshiro Hiramoto 東京大學 |  Atsushi Takahashi 東京工業大學 |
|  | 駱韋仲 工業技術研究院 | 陳中和　成功大學程瑞曦 工業技術研究院  |

本屆大會之贊助廠商將享有以下優惠之服務，以茲銘謝：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贊助額(台幣)** | **贊助三萬元** | **贊助五萬元** | **贊助十萬元** |
| **優惠項目** | **(含以上)** | **(含以上)** | **(含以上)** |
| **一名免費名額** | ● |  |  |
| **三名免費名額 (原註冊費用為TWD 68,400)** |  | ● |  |
| **十名免費名額 (原註冊費用為TWD 228,000)** |  |  | ● |
| **每增加一萬增加一名免費名額** |  | ● | ● |
| **會場放置貴公司介紹簡介** | ● | ● | ● |
| **大會形象牆展示貴公司企業標誌** |  | ● | ● |
| **會場播放企業形象影片** |  | ● | ● |
| **主管列名大會顧問委員會** |  |  | ● |
| **大會議程手冊標印贊助廠商logo** | ● | ● | ● |
| **大會網站超連結至贊助廠商網站** |  | ● | ● |
| **大會議程手冊刊登半頁公司資訊** |  |  | ● |

*\*上述 免費名額可任選參加VLSI-TSA或VLSI-DAT研討會。*

*相關研討會訊息敬請參考如下網站，謝謝。*

<https://expo.itri.org.tw/2021VLSITSA>

<https://expo.itri.org.tw/2021VLSIDAT>

|  |
| --- |
| **DAT贊助同意書**贊助金額：新台幣　 　　　　萬元整 |

|  |  |
| --- | --- |
| 　企業　　全銜　團體 | 中文英文 |
| 列名顧問委員會之主管 (Advisory Committee)(10萬以上) | 中文／職銜英文／職銜 |
| 聯絡人 |  | 職稱 |  |
| 電話 |  | 傳真 |  |
| 營利事業統一編號 |  | Email |  |
| 地址 |  |
| 網址 |  |
| 報名業務負責人 |  | Email |  |
| 電話 |  | 傳真 |  |

＊貴公司同意贊助後，將另行向聯絡人索取貴公司Logo電子檔及相關資訊以利後續文宣品製作。如蒙惠允贊助，請於2021/2/26前email 或 傳真回覆『DAT 贊助同意書』至大會公關組，大會將檢附正式收據洽請貴公司撥款，感謝您的支持！

**研討會贊助款撥款方式：電匯／即期支票**

**抬頭：工業技術研究院（統編：02750963）**

電匯銀行：戶名：財團法人工業技術研究院

土地銀行工研院分行，帳號：156005000025（電匯方式請務必先傳真收執聯）

郵寄地址：31057新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館720室 王佳雯小姐收

**2021 VLSI-DAT 公關組聯絡人：**

王佳雯 聯絡電話： 03-591-5828 傳真：03-582-0420 E-Mail: sara@itri.org.tw